

技术参数

7123

日期 : 09/2021
上海禧合应用材料



应用介绍

特点

一款双组份环氧树脂胶，常温或低温可固化，具有高粘接强度，低膨胀等特点，适用于电子器件结构性粘接固定；并具有较高的可靠性及耐候性

粘接材料

金属，塑料/PCB，玻璃，陶瓷等

典型应用

电子元器件结构性粘接

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂	
颜色	A: 微白色; B:微黄色	
粘度(cps)	A:10200; B:6800	20rpm@25°C, ASTM D-1084
混合比例 (体积)	2:1	
固化条件*	1hrs/60°C 6hrs/25°C初固+24hrs 完全固	
有效期@ 25°C,月	12	

*固化温度是指胶水表面实际达到的温度

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	微黄色	
邵氏硬度	64D	ASTM D-2240
玻璃化温度	55°C	DSC,TAQ20, 40°C/Min
剪切强度 MPa	3.8	ABS / ABS
降解温度	350°C	
可靠性	数值	测试方法
固化失重	≤1%	
工作温度范围	-55°C—150°C	

储存和使用方法

请将产品常温25°C下储存，建议储存在干燥通风处，使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考SDS文件；

注：

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。

www.stick1mat.com

Email: info@stick1mat.com

上海老港工业区同发路 123 弄 12-1 号

